

(사)한국마이크로전자 및 패키징학회

2024년 정기학술대회 (정승부 교수님 정년기념 특별심포지엄)

- 일시** 2024년 4월 3일(수) ~ 4일(목)
- 장소** 광주광역시 국립아시아문화전당 (문화전당역) 문화정보원 국제회의실 (B1F) 및 대강의실 (B1~B2F)
- 주관** (사)한국마이크로전자 및 패키징학회, **광주테크노파크**
- 후원** **광주광역시**, **조선대학교**, **전남대학교**, **전자신문**, **조선이공대학교** 차세대반도체 혁신융합사업단

초대의 말씀

2024년 4월 3일(수)~4일(목) 양일간 (사)한국마이크로전자 및 패키징학회 정기학술대회를 광주광역시 국립아시아문화전당에서 개최합니다. 본 학회는 정기적 국내외 학술대회, 학술지 발간 및 포럼, 세미나 등을 통해 마이크로전자 및 패키징 기술 관련 국내를 대표하는 유일무이한 학회로 거듭나고 있습니다. 이번 학술대회는 반도체 및 전자 패키징 기술 전반에 대한 발표와 더불어 최근 주목받고 있는 이종집적, 칩렛 등 차세대 첨단 패키징 기술에 대한 연구동향을 공유하는 시간으로 마련하였습니다. 최근 반도체 후공정을 대표하는 패키징 기술이 반도체 산업에서 무엇보다도 중요한 시기이며 전 세계적으로 참여한 기술 개발 경쟁이 이루어지고 있습니다. 학술대회를 통해, 산업동향과 반도체 패키징 기술변화를 파악하고 대한민국 반도체 및 패키징 산업의 미래를 준비하는 교류의 장이 될 것을 확신합니다. 부디 많은 관심과 적극적인 참여를 부탁드립니다.

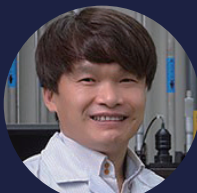
Keynote Speaker



김대우 상무
삼성전자(주)



손호영 부사장
SK하이닉스(주)



최광성 연구위원
한국전자통신연구원 (ETRI)



권석준 교수
성균관대학교



이훈택 상무
제이엡스테츠칩팩코리아(유)

Notice

- 사전등록: ~3월 22일(금) 오후 6시 온라인 사전 등록 마감
- 세션정보: Keynote Talk, 초청강연, 특별세션, 일반 구두발표, Young Scientist (학생) 구두발표, 포스터 발표 등 다양한 구성
- 구두 발표 세션: 현장 강연
- 포스터발표 세션: 포스터 부착 및 현장 발표
- 견학 프로그램: 한국광기술원-한국생산기술연구원-한국전자기술연구원 견학 (무료, 선착순 40명, 홈페이지 안내 및 신청)
- 시티투어 프로그램: 홈페이지 참조 (무료, 선착순 40명, 홈페이지 신청)
- 기업체 등 부스 운영

중요 일정

| 일정 | 내용 |
|--------------|------------------|
| 2024. 3. 8. | 제목 마감 (웹사이트 등록) |
| 2024. 3. 22. | 초록 마감 (웹사이트 업로드) |
| 2024. 3. 22. | 온라인 사전등록 마감 |

※ 초록 양식은 웹사이트를 통해 다운로드

행사 일정

| 일정 | 내용 |
|-----------|---|
| 4월 3일 (수) | 개회식, Keynote Talk, 초청강연, 특별세션, 일반 발표, 학생 (Young Scientist) 발표, 포스터 발표, 정년퇴임 기념식, 학회상 시상식, 발표 시상식, 기업체 부스 운영 |
| 4월 4일 (목) | Keynote Talk, 초청강연, 특별세션, 일반 발표, 견학, 시티투어, 폐회식 |

※ 발표 시간: Keynote Talk 30분, 초청/특별/일반 20분, 학생 15분
※ 상기 일정은 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

주제 분야

차세대 첨단 반도체/전자 패키징 기술

- 2.5D & 3D 패키징, 이종집적 및 칩렛 기술, 자동차 전장 등 신규 첨단 패키징 기술
- Advanced interconnect, substrate 등 전자패키징 소재/장비/공정 기술
- 센서, 반도체 소자, 유연소자 등 마이크로 전자부품 기술
- 열적, 기계적, 전기적 특성/신뢰성 등 설계, 측정, 평가, 전산모사 기술

등록비 (3인 등록 시 추가 1인 무료 (3+1))

| | 일반 정회원 | 일반 비회원/준회원 | 학생 정회원 | 학생 비회원/준회원 |
|------|---------|------------|---------|------------|
| 사전등록 | 170,000 | 220,000 | 70,000 | 100,000원 |
| 현장등록 | 200,000 | 250,000 | 100,000 | 130,000원 |

※ 3인 등록 시 추가 1인 무료 (3+1)의 경우 일반/학생 혼합 등록 시 무료 등록은 학생에 한함

※ 등록비 포함 내역

- 일반: 전체 강연 및 발표, 석식 (1회), 음료 및 다과 등
- 학생: 전체 강연 및 발표, 음료 및 다과 등
(학생 참석자가 석식을 원할 경우 홈페이지에서 유료 (1만원) 신청 가능)

※ 회원 구분

- 정회원: 당해년도 연회비 납부 회원
- 준회원: 당해년도 연회비 납부하지 않은 회원
- 비회원: 학회 미가입
- 단체회원사: 연회비 납부한 경우 소속 직원 모두 정회원 인정

숙박 안내

- 라마다프라자충장 호텔 (도보 20분 내외)
 - 예약 문의 062-717-1000 | 예약 이메일 resv@ramadaplazachungjang.com
- 컬쳐호텔 램 (도보 5분 내외)
 - 예약 문의: 062-223-1500 | 예약 이메일: laam.reserve@gmail.com

※ 호텔 예약과 관련하여 자세한 내용은 홈페이지 안내사항을 참고하시기 바랍니다.

※ 본 호텔은 이번 학술대회 협력 호텔로 할인가가 적용되었습니다.

할인가를 적용 받으시려면 반드시 학회 홈페이지에 첨부된 양식으로 예약 진행하셔야 합니다.

행사 기간 내 혼잡으로 예약이 어려울 수 있으니 서둘러 주시기 바랍니다.

CONTACT

- 주최: (사)한국마이크로전자 및 패키징학회
- 담당: 김민진 간사, E-mail: kmeps@kmeps.or.kr, Tel: 02-538-0962, Fax: 02-538-0963



(사)한국마이크로전자 및 패키징학회

2024년 정기학술대회 (정승부 교수님 정년기념 특별심포지엄)

| 2024년 4월 3일 (수) | | |
|-----------------|---|---|
| | Young Scientist Session I – Advanced Packaging Technology (좌장: 강수민/서울과학기술대학교) | Young Scientist Session II – Test & Simulation (좌장: 연한울/광주과학기술원) |
| | 국제회의실 (B2F) | 대강의실 (B1~B2F) |
| 10:00 – 10:15 | 전처리가 SiO2/Cu 본딩 특성에 미치는 영향 김인주 (서울과학기술대학교) | 재현평가를 통한 OSP 사용 PCB 표면에서 발생하는 미접합 불량 분석법과 메커니즘 김하영 (국립한밭대학교) |
| 10:15 – 10:30 | 전기도금 조건에 따른 Cu grain 크기 분석과 wet etch rate에 관한 연구 김택현 (한양대학교) | 3D Thermal Property Imaging System Based on Frequency-domain Thermoreflectance 김지현 (성균관대학교) |
| 10:30 – 10:45 | Cu/Sn/Cu 구조의 마이크로 범프 접합부 금속간화합물이 열-기계적 신뢰성에 미치는 영향 최영란 (한국생산기술연구원) | 에폭시 몰딩 컴파운드의 내부 구조에 따른 흡탈습 거동 평가 구창연 (한국과학기술원) |
| 10:45 – 11:00 | 저온 하이브리드 본딩을 위한 Ar/N2 2단계 플라즈마 처리가 Cu-Cu 및 SiO2-SiO2 접합 특성에 미치는 영향 분석 김가희 (국립안동대학교) | Cu-Cu direct bonding 에서의 공정 변수에 따른 void formation 에 대한 numerical parametric study 오성현 (성균관대학교) |
| 11:00 – 11:15 | 초미세 멘드라이트형 Cu 입자 함성과 이를 함유한 Cu 페이스트의 초고속 가압 소결접합 특성 정상훈 (서울과학기술대학교) | Driving Force for Joining at 175 °C Low-temperature Sinter Joining Using Time Domain-dependent Ag-Au Epitaxy and Interfacial Stress 김서아 (한국생산기술연구원) |
| 11:15 – 11:25 | Coffee Break | |
| | 개회식 (진행: 손윤철/조선대학교) | |
| | 국제회의실 (B2F) | |
| | 축사 & 개회사 | |
| | Keynote Speech I, II (좌장: 손윤철/조선대학교) | |
| | 국제회의실 (B2F) | |
| 11:40 – 12:10 | Advanced Package Technology for the era of AI 김대우 상무 (삼성전자(주)) | |
| 12:10 – 12:40 | Advanced Packaging Technology for Leading-Edge HBM and Beyond HBM 손호영 부사장 (SK하이닉스(주)) | |
| 12:40 – 14:00 | Lunch | |
| | 포스터 발표 (오전 10시까지 부착) | |
| | 국제회의실 Lobby (B2F) | |
| 14:00 – 15:00 | 포스터 심사 (좌장: 고용호/한국생산기술연구원) (심사위원: 박지용/한국생산기술원, 한기진/동국대학교) | |
| | 특별세션 I – 정승부 교수님 정년기념 특별 심포지움 I (좌장: 윤정원/충북대학교) | Advanced Interconnection (좌장: 김영천/안동대학교) |
| | 국제회의실 (B2F) | 대강의실 (B1~B2F) |
| 15:00 – 15:20 | 신축성 전자 소자 구현을 위한 기판 및 전극 기술 김종웅 (성균관대학교) | (Invited) 면광원 레이저 접합을 적용한 반도체패키지 인터커넥션 공정기술 유세훈 (한국생산기술연구원) |
| 15:20 – 15:40 | 나노복합재 활용 전자패키지 열관리 기술 연구 김광석 (한국생산기술연구원) | (Invited) 마이크로 엘이디 디스플레이를 위한 레이저 공정용 접합 소재의 공정 조건 연구 개발 엄용성 (한국전자통신연구원) |
| 15:40 – 16:00 | 차세대 자동차 기술 개발 현황 및 소재/접합 이슈 최돈현 (현대모비스) | 무전해 주석 도금을 이용한 Cu OSP 패드의 범프 냉납 위험성 평가법 진수향 (대덕전자(주)) |
| 16:00 – 16:20 | Overview of Power Management IC Front-end Process 방기완 (SK하이닉스(주)) | Bonding Wire Insulated, Passivated & Adhesively-Promoted Using Nano Al2O3 Coating 박수재 (OxWires Co. Ltd.) |
| 16:20~16:40 | Coffee Break | |
| | 특별세션 II – 정승부 교수님 정년기념 특별 심포지움 II (좌장: 김종웅/성균관대학교) | Advanced Materials and Process I (좌장: 방정환/한국생산기술연구원) |
| | 국제회의실 (B2F) | 대강의실 (B1~B2F) |
| 16:40 – 17:00 | Bonding Materials and Methods for Reliable Electronic Packages 윤정원 (충북대학교) | The Trend of Interferometric Technologies in the Advanced Package for HBM 유준호 ((주)넥센서) |
| 17:00 – 17:20 | Development of High-performance Contact Materials for Electronic Components 안지혁 (한국재료연구원) | (Invited) 패키지 및 인터커넥션-레벨 하드웨어 보안 연구 김영우 (세종대학교) |
| 17:20 – 17:40 | Micro Joining Technology for Consumer Electronics 구자명 (삼성전자(주)) | 페실리콘 슬러지의 재활용을 통한 고순도 실리콘의 제조 및 차세대 소재로의 응용법 윤창민 (국립한밭대학교) |
| 17:40 – 18:00 | EV 파워모듈용 양면 플립칩 접합 기술 최정현 (LG전자 생산기술원) | 반도체 장비 디지털 트윈 VR 훈련과 역설계 교육과정 김연희 (호서대학교) |
| | 정년기념행사 & 시상식 & Lucky draw (진행: 윤정원/충북대학교, 고용호/한국생산기술연구원, 김태일/성균관대학교) | |
| | 국제회의실 (B2F) | |
| 18:00 – 18:30 | 정년기념행사, 학회상 시상식, 학생 발표 시상, 1일차 Lucky draw | |
| | 디너 & 기념 행사 (진행: 이소연/금오공과대학교) | |
| | 라마다플라자 충장호텔 로즈마리룸 (12F) | |
| 19:00 – 21:00 | 내빈소개, 광주TP 사업 소개 및 석식 (*정승부 교수님 정년기념만찬: 라마다플라자 충장호텔 라벤더룸 대연회장 (13F)) | |

(사)한국마이크로전자 및 패키징학회

2024년 정기학술대회 (정승부 교수님 정년기념 특별심포지엄)

2024년 4월 4일 (목)

| | | |
|---------------|---|--|
| | Advanced Materials and Process II (좌장: 남승훈/명지대학교) | 특별세션 III - 해동젊은공학인상 & 학회상 수상자 특별세션 (좌장: 강준상/한국과학기술원) |
| | 국제회의실 (B2F) | 대강의실 (B1~B2F) |
| 9:30 - 9:50 | (Invited) Process and Equipment Challenges for Heterogeneous Integration 윤민승 (램리서치코리아) | 1st 와 2nd 레벨 패키징을 위한 다양한 소재 및 공정 기술 연구 고용호 (한국생산기술연구원) |
| 9:50 - 10:10 | (Invited) AI 기반 반도체 공정 및 설비 이상탐지 솔루션 소개와 실제 활용 사례 성기석 (주알티엠피) | 복합체 기반 압전 나노파이버를 이용한 에너지 하베스트 및 센서 응용 민성욱 (경기대학교) |
| 10:10 - 10:30 | 칩렛, SIP 향 최신 고방열/전자파 차폐 기술 정세영 (엔트리움(주)) | 고해상도 근접 센서, 자율 주행 및 5G/6G 통신 시스템을 위한 94GHz 팬아웃 웨이퍼 레벨 패키징 (FOWLP) 주지호 (한국전자통신연구원) |
| 10:30 - 10:50 | Eco-friendly, high-strength MXene/Cellulose nanofiber composite paper for EMI shielding 우윤성 (단국대학교) | Power Module Packaging and Cooling Technology for Electric Vehicle Inverters 김동진 (한국생산기술연구원) |
| 10:50 - 11:10 | Coffee Break | |
| | Keynote Speech III, IV, V (좌장: 권대일/성균관대학교) | |
| | 국제회의실 (B2F) | |
| 11:10 - 11:40 | 마이크로 LED 디스플레이용 혁신 기술 최광성 연구위원 (한국전자통신연구원, ETRI) | |
| 11:40 - 12:10 | 글로벌 반도체 공급망 변동과 한국의 대응 전략 권석준 교수 (성균관대학교) | |
| 12:10 - 12:40 | Revolution of Microsystem Integration 이훈택 상무 (제이셋스테츠헤프코리아(주)) | |
| 12:40 - 13:20 | Lunch | |
| | Thermal Management (좌장: 박아영/한국기계연구원) | Package, Module & Substrate (좌장: 김동진/한국생산기술연구원) |
| | 국제회의실 (B2F) | 대강의실 (B1~B2F) |
| 13:20 - 13:40 | (Invited) Thermal Conductivity of Liquid-phase Sintered Silicon Carbide Ceramics 김현식 (서울시립대학교) | (Invited) 반도체 미세 프로브핀을 위한 고강도, 고전도도 CuAg 도금 박판 제작 최승희 (한국공학대학교) |
| 13:40 - 14:00 | (Invited) Thermal Property Measurements for Device and Packaging Applications 조정완 (성균관대학교) | (Invited) What AI era will Give to SOC Package in Mobile Application? 이희석 (삼성전자(주)) |
| 14:00 - 14:20 | AI 반도체 방열 기술 동향과 vapor chamber 기술 구경하 (한화엔엑스엠디(주)) | 패키지기판 위 선풍/간격 3 μ m의 다층 RDL 제작 공정 개발 박경호 (한국나노기술원) |
| 14:20 - 14:40 | 탄소섬유 발열체를 이용한 패키징 접착 잔류 용력 및 에너지 저감에 관한 연구 김성수 (한국과학기술원) | 첨가제 기반 미세조직 제어 전해 도금 기술을 이용한 구리 박막의 물성 제어 박현 (동아대학교) |
| | 폐회식 (좌장: 고용호/한국생산기술연구원) | |
| | 국제회의실 (B2F) | |
| 14:40 - 14:45 | 폐회사 & 2일차 Lucky Draw | |
| | 견학 (선착순 40명) | 시티투어 (선착순 40명) |
| | 주차장 | 주차장 |
| 15:00 - 17:30 | 국립아시아문화전당 (ACC) → 한국생산기술연구원 → 한국전자기술연구원 → 한국광기술원 → 광주송정역 | 국립아시아문화전당 (ACC) → 5·18국립묘지 → 광주호 호수 생태원 → 광주송정역 |

(사)한국마이크로전자 및 패키징학회

2024년 정기학술대회 (정승부 교수님 정년기념 특별심포지엄)

| Session | No. | Title | Author | Affiliation |
|----------------------------|-------|---|-------------------|-------------|
| 1. 전자패키징 소재/장비/공정 기술 | P1-01 | Oxidation-free bonding of Ag nanoporous sheets to bare Cu substrates for enhanced EMC molding | 조은진 | 한국생산기술연구원 |
| | P1-02 | Driving forces of oxidation-free cold copper sinter bonding in the air | 김예리 | 한국생산기술연구원 |
| | P1-03 | 비전도성 접착제와 Ni-Less 표면처리를 적용한 미세피치 플립칩 인터커넥션 기술의 최적화 연구 | 이태영 | 한국공학대학교 |
| | P1-04 | 전기방사를 활용한 고방열 EMC용 첨가 소재의 개발 | 추연룡 | 국립한밭대학교 |
| | P1-05 | EMC 폐기물의 재활용을 통한 균일한 실리카의 제조 및 CMP Slurry 응용 | 제갈석 | 국립한밭대학교 |
| | P1-06 | 포토리소스트 공정에서 발생할 수 있는 슬러지의 인자 확인 및 형성 방지법의 제안 | 김찬교 | 국립한밭대학교 |
| | P1-07 | 반도체 제조 공정에서 발생하는 실리콘을 함유한 슬러지를 재활용한 자율주행차량용 검은색 소재의 제조 | 김지원 | 국립한밭대학교 |
| | P1-08 | 레이저 기반 상온 접합 공정 및 레이저 비전도성 페이스트를 적용한 인듐 솔더 접합부의 신뢰성 분석 | 정지은 | 한국전지통신연구원 |
| | P1-09 | 레이저 기반 상온 접합 공정으로 형성된 솔더 조인트의 신뢰성 전/후 미세구조 분석 | 이기은 | 한국전지통신연구원 |
| | P1-10 | 리플로우 에너지원 변화에 따른 솔더 접합부 특성 | 이효원 | 충북대학교 |
| | P1-11 | CMP 공정 대체를 위한 RDL의 평탄화 방법 | 강민지 | 서울과학기술대학교 |
| | P1-12 | Soldering on Reliability of BGA Package with SAC 305/SACBI Solder joint | 성민재 | 성균관대학교 |
| | P1-13 | 미세 피치 적용을 위한 type 7 수용성 솔더 페이스트 개발 및 특성 평가 | 최동규 | 한국생산기술연구원 |
| | P1-14 | LAB (Laser-Assisted Bonding) 및 Type 8 솔더 페이스트를 이용한 접합의 기계적 특성 | 구준호 | 서울시립대학교 |
| | P1-15 | Adhesive-free bonding of flexible substrates by using laser heating | 이은혜 | 한국생산기술연구원 |
| | P1-16 | Soldering Temperature Control using Photonic Energy by Light Absorption Differences | 노태준 | 성균관대학교 |
| | P1-17 | Cu 결정립 크기 및 방향 변화에 따른 Sn-Ag-Cu 솔더 접합부 금속간화합물 형성 및 성장 거동 | 한다경 | 충북대학교 |
| | P1-18 | A mathematical model analyzed how Boron Carbide filler in Ceramic/Epoxy composites affects the thermal behavior of an IC package. | ABDALLAH AL SALIM | 성균관대학교 |
| | P1-19 | 재배선 공정 평탄화를 위한 선택적 구리 충전 및 구리 전해연마 연구 | 오재환 | 한양대학교 |
| | P1-20 | Al ₂ O ₃ ALD layer 증착 두께에 따른 솔더 접합부 특성 평가 | 노은채 | 충북대학교 |
| | P1-21 | 고주파 소자용 저온 경화형 polyimide 기반 저유전 소재 개발 및 특성 연구 | 남현진 | 한국전자기술연구원 |
| | P1-22 | Effects of Pulse Plating Parameters in FeNi Alloy Electroplating | 강나영 | 홍익대학교 |
| | P1-23 | 면광원 레이저 인터커넥션을 적용한 DPIG/Sn-3.0Ag-0.5Cu 솔더 접합부 취성파괴특성 평가 | 한성희 | 한국생산기술연구원 |
| | P1-24 | Ag 코팅 Cu 입자 함유 자체 발열 필름 소재의 소결접합 특성 | 이혜민 | 서울과학기술대학교 |
| | P1-25 | pH 조절에 의해 합성된 Cu 입자의 입도 분석 및 소결 접합 특성 | 김호륜 | 서울과학기술대학교 |
| | P1-26 | Sn-57Bi-1Ag 솔더페이스트 도포 중형비 조건에 따른 Sn-3.0Ag-0.5Cu 솔더와 접합부 특성 평가 | 임태윤 | 한국생산기술연구원 |
| | P1-27 | 면광원 레이저 인터커넥션 공정을 적용한 Cu/SnAg 필러 범프 접합부의 미세조직 및 기계적 물성 연구 | 한상은 | 한국생산기술연구원 |
| | P1-28 | 차세대 반도체 Ru 배선 적용을 위한 ALD ZnO 확산방지층의 공정 열처리 조건에 따른 계면접착에너지 평가 및 분석 | 정대윤 | 국립안동대학교 |
| | P1-29 | 차세대 반도체 배선 적용을 위한 ALD Ru/ZnO 박막의 공정 열처리 유무에 따른 계면접착에너지 평가 및 분석 | 김민진 | 국립안동대학교 |
| | P1-30 | Interfacial reaction and drop reliability of hybrid BGA packages with different surface finished PCBs | 김세환 | 성균관대학교 |
| | P1-31 | 대기압 플라즈마로 소결된 구리-흑연 복합 시트의 접착 특성 | 정건주 | 한국생산기술연구원 |

(사)한국마이크로전자 및 패키징학회

2024년 정기학술대회 (정승부 교수님 정년기념 특별심포지엄)

| Session | No. | Title | Author | Affiliation |
|------------------------|-------|---|--------|-------------|
| 2. 설계, 측정, 평가, 전산모사 기술 | P2-01 | FMMEA 기반 액침냉각 데이터센터의 잠재적 신뢰성 문제 식별 | 이중언 | 성균관대학교 |
| | P2-02 | 새로운 샌드위치 구조의 광학적으로 투명한 접착제를 위한 폴리디메틸실록산의 기계적 물성 | 김도훈 | 한국과학기술원 |
| | P2-03 | 극성 유기용매가 PEDOT:PSS 하이드로겔의 기계적 물성에 미치는 영향 | 강원중 | 한국과학기술원 |
| | P2-04 | 생성형 예측 모델을 적용한 박막의 신뢰성 평가를 위한 물 표면 플랫폼에서의 데이터 추출 시스템 개발 | 송명 | 한국과학기술원 |
| | P2-05 | FCLBGA 패키지 내 Solder Ball 배열에 따른 열전달 특성 및 패키지 변형 분석 | 장희찬 | 인하대학교 |
| | P2-06 | 2D 머신비전 기반 다양한 패키지 표면 불량 검사 솔루션 | 한기준 | 한성대학교 |
| | P2-07 | 저전압 동작 메모리의 신뢰성 평가 방법 | 석주환 | 성균관대학교 |
| | P2-08 | 파워 반도체 패키징 역공학과 고장 분석 영역에서 실리콘 젤 제거의 중요성 | 이규석 | 한국전자기술연구원 |
| | P2-09 | Analysis of Thermal and Mechanical Properties in Homogeneous and Heterogeneous Full-LTS BGA | 윤재준 | 성균관대학교 |
| | P2-10 | 하이브리드 본딩을 위한 Cu-Cu 접합 구조의 열 측정 방법론 | 김학준 | 서울대학교 |
| | P2-11 | 탄소섬유 발열체의 발열특성 연구 | 박영주 | 한국생산기술연구원 |
| | P2-12 | Investigating thermal and mechanical characteristics of pogo pin: Intrusion and contact resistance analysis. | 레이수안바키 | 서울과학기술대학교 |
| | P2-13 | 나노압입시험을 통한 PI 기판에 증착된 Al, Cu 박막의 탄성계수 측정 | 박지현 | 국립안동대학교 |
| | P2-14 | 유한요소해석 기반 머신러닝을 활용한 금속박막의 기계적 특성 예측 | 김동엽 | 국립안동대학교 |
| | P2-15 | 전산유체역학 시뮬레이션을 이용한 솔더 페이스트 스텔실 인쇄공정 분석 | 김형태 | 부산대학교 |
| | P2-16 | 레이저 파쇄 기술을 이용한 박막 계면 물성 측정 | 이세민 | 한양대학교 |
| | P2-17 | 전산해석을 통한 전해동박 두께 편차의 유동 영향 평가 | 유강민 | 한국재료연구원 |
| | P2-18 | Thermal Strain Measurement of heterogeneous interfaces in Electronic Packages | 이민혁 | 한국생산기술연구원 |
| | P2-19 | Feasibility Study of Semiconductor Packaging Interconnection Defect Detection Method Using Background Removal Technique | 오찬영 | 한국과학기술원 |
| | P2-20 | 전이학습을 이용한 에폭시 나노복합재료의 데이터 기반 멀티스케일 해석 기법 | 이원주 | 인하대학교 |
| | P2-21 | Comparative study on heat dissipation analysis according to ceramic substrate materials of SiC power module | 김기철 | 강남대학교 |
| | P2-22 | 630 ~ 850 nm 다파장 LLLT(Low level laser therapy) 광모듈의 광학적특성측정법과 신뢰성 분석 | 김현 | 전남대학교 |
| | P2-23 | 태양광 인버터 수명 향상을 위한 땀납 합금 및 기판 표면 연구 | 이레 | 전남대학교 |
| | P2-24 | PI/PI 유연소자의 접착 방법에 따른 굽힘 변형률 측정 | 함주빈 | 국립안동대학교 |
| | P2-25 | 에폭시 강인화제 첨가에 따른 고방열 에폭시 밀봉재의 열 및 기계적 특성 연구 | 정제용 | 한국생산기술연구원 |

(사)한국마이크로전자 및 패키징학회

2024년 정기학술대회 (정승부 교수님 정년기념 특별심포지엄)

| Session | No. | Title | Author | Affiliation |
|-----------------|-------|---|---------------|-------------|
| 3. 첨단 패키징 기술 | P3-01 | 스마트워치용 밴드에 내재가 가능한 유연한 메모리 제품 개발 | 이혁 | 호서대학교 |
| | P3-02 | 레이저 전사 접합을 적용한 Cu/Sn-1.8Ag 미세범프의 전류 및 열사이클 복합하중에 따른 계면 반응 분석 | 권용범 | 국립안동대학교 |
| | P3-03 | Investigation of electrochemical migration behavior of various surface treatment | 강동길 | 성균관대학교 |
| | P3-04 | 하이브리드 본딩에서 Cu-Cu bonding 을 위한 분석적 접근 | 이시예 | 서울과학기술대학교 |
| | P3-05 | Advanced interconnections of aluminum and copper flexible printed circuit boards for battery management systems using regional and transient laser-assisted soldering | 김서아 | 한국생산기술연구원 |
| | P3-06 | Optimization of hybrid bonding process conditions through numerical analysis | 레이수안바익 | 서울과학기술대학교 |
| | P3-07 | A comprehensive study of preventing crack formation in 2.5D glass interposer | 레이수안바익 | 서울과학기술대학교 |
| | P3-08 | 전력반도체의 고강도 접합을 위한 무가압 은 나노 페이스트 소결 기술 | 구모세 | 서울과학기술대학교 |
| | P3-09 | 저온 솔더링 적용을 위한 갈륨과 다층구조 UBM 간의 계면반응 연구 | 심윤섭 | 조선대학교 |
| | P3-10 | 고온 장기 시효에 따른 Sn-2.3Ag flip-chip solder bump 접합부의 금속학적 반응 및 기계적 특성 평가 | 장은수 | 충북대학교 |
| | P3-11 | 유리관통전극 (TGV) 을 위한 선택적 구리 전극 증착 방법 | YANG FAN | 한양대학교 |
| | P3-12 | 광펄스 솔더링을 이용한 Sn-58Bi 무연솔더 접합공정 연구 | 고혜리 | 조선대학교 |
| | P3-13 | MXene 나노입자를 포함하는 무연복합솔더 개발에 관한 연구 (A study on the development of lead-free composite solder containing MXene nanoparticles) | 김민형 | 조선대학교 |
| | P3-14 | DAF-less Chip Stacking PKG using Self-Assembled Monolayer | 김원빈 | 서울대학교 |
| | P3-15 | 전사 인쇄를 활용한 다종의 박막 반도체 이중 집적 3D IC 기술 | 홍성우 | 한양대학교 |
| | P3-16 | 주석과 니켈 적층 금속 프리폼을 이용한 천이액상확산 접합 | 이동복 | 충북대학교 |
| | P3-17 | 팬아웃 패키징 재배선 적용을 위한 PI 절연층의 온도에 따른 박막 응력 평가 및 분석 | 김범기 | 국립안동대학교 |
| | P3-18 | Self-Assembled Monolayers (SAMs)을 이용한 Cu-Cu 접합 | 김용석 | 충남대학교 |
| | P3-19 | Direct deposition of silver in through glass via hole by inkjet printing | Hamza Hussain | 성균관대학교 |
| 4. 마이크로 전자부품 기술 | P4-01 | 동시전사접합기술 기술을 이용한 마이크로 발광다이오드의 전사, 접합, 그리고 수리 | 신정호 | 한국전자통신연구원 |
| | P4-02 | 건전성 예측관리기술 소개 및 연구동향: Electronics 분야 | 김대환 | 성균관대학교 |
| | P4-03 | 저차원 유무기 복합 페로브스카이트 박막 제조 및 분석 | 이세영 | 충남대학교 |
| | P4-04 | 3D Transfer printing technology using shape deformable PVA-based stamp | 양현지 | 한양대학교 |
| | P4-05 | Permittivity Change of Dielectro-elastic Composite with Stretchable and stretch-Unresponsive Wireless Electronics | 최건오 | 한양대학교 |
| | P4-06 | Self-recoverable, elastic electrospun thermoplastic polyurethane integrated with fluorinated ethylene propylene for applying triboelectric nanogenerator | 트란 독 칸 | 성균관대학교 |
| | P4-07 | Development of Self-Healing Triboelectric-Based Pressure Sensor with Contact Time Responsiveness | 최수빈 | 성균관대학교 |
| | P4-08 | Ni-Mn-Co 기반 NTC온도센서의 AI 도핑에 따른 구조 분석 및 특성평가 | 전하윤 | 경기대학교 |